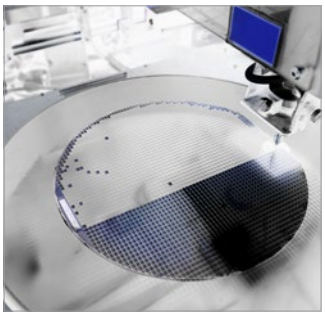
Cu

Stand: 1. August 2025

umicore

IntraCu® Additive

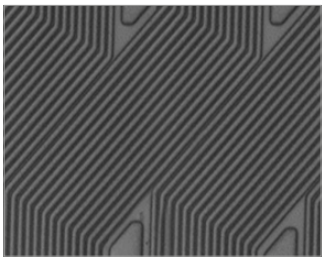


Bringen Sie Advanced Packaging auf ein völlig neues Niveau

Der Umicore-Geschäftsbereich Electroplating bietet innovative, patentierte Additive für die Kupfergalvanisierung für die moderne Advanced Packaging Industrie an.

Das modulare Additivsystem IntraCu® ist ein integraler Bestandteil unseres gemeinsamen Produktangebots. Es wird in einer hochmodernen Reinraumumgebung hergestellt, um die Qualitätsstandards der Halbleiterindustrie zu erfüllen.

IntraCu® Additive können als Drop-in-Ersatz für aktuelle Standardverfahren für Microbumps in IC-Packages, RDL im Wafer Level Packaging und Pillar im Flip-Chip-Packaging angesehen werden



Vorteile

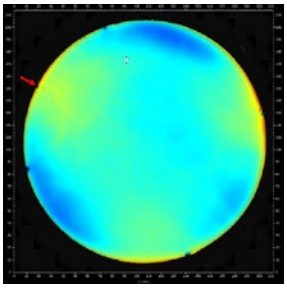
- Bambus-ähnliche Struktur
- Mattes Cu, Ra < 0,2 µm
- Flache Topographie
- Stabile Zugfestigkeit
- Resistent gegen Kornwachstum
- Beständig gegen Ätzen
- Glänzendes Kupfer, Ra < 0.03 µm
- ±50% Prozessfenster für Cu Pillar and RDL
- Total in-film Organik < 11 ppm
- Geringste Ausbildung von Kirkendall-voids

Anwendungen

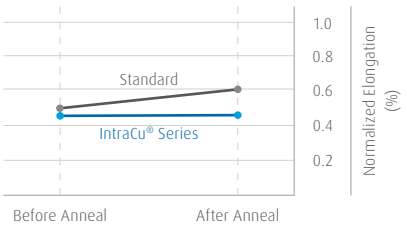
- Fine line RDL (< 2 µm)
- Cu-to-Cu Direkt-Bonding
- 2-in-1 glänzendes Kupfer (Cu pillar and RDL)
- 2-in-1 für geringste Anzahl an Kirkendall voids

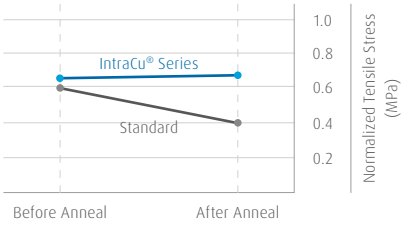
IntraCu® Additive

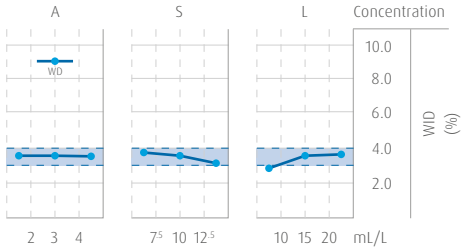
TECHNISCHE DATEN

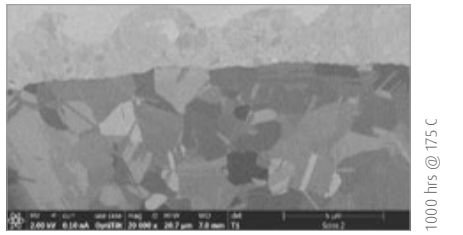


Very low stress of IntraCu® SC layers: 8 inch blanket wafer, plated on one side with 20 µm, shows warpage < 10 µm.









ANSPRECHPARTNER

Sie haben tiefergehende Fragen oder wünschen eine unverbindliche Angebotskalkulation?
Unsere Fachleute helfen Ihnen, natürlich auch bei technischen Fragen, gerne weiter.

Andrea Grau
Leiterin Vertrieb Europa

E-Mail: andrea.grau@eu.umicore.com
Telefon: +49 (0) 7171 607 - 229

umicore

Wir halten die hier gemachten, auf unseren Erfahrungen im Bereich Forschung und Anwendungstechnik beruhenden Informationen und Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für korrekt, können jedoch – sofern nicht schriftlich vereinbart – diesbezüglich keine Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernehmen; dies gilt unter anderem auch im Hinblick auf zu erzielende Ergebnisse.